

## DDR2 SO DIMM

TE 内部编号 292406-4

SO DIMM Sockets, Double Data Rate (DDR) 2, Stack Height .157 in [4 mm], Right Angle Module Orientation, 200 Position, DDR2 SO DIMM

[在 TE 官网查看>](#)
[连接器](#) > [接口插槽](#) > [内存插槽](#) > [SO DIMM 插槽](#) > [DDR2 SO DIMM 插槽](#)


DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 2

堆叠高度: 4 mm [.157 in]

模块方向: 直角

位数: 200

中心线 (间距) : .6 mm [.024 in]

[所有 DDR2 SO DIMM 插槽 \(30\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 连接器系统     | 缆到板            |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板          |
| DRAM 类型   | 双倍数据速率 (DDR) 2 |

### 结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 托架数  | 2   |
| 钥匙数  | 1   |
| 行数   | 2   |
| 模块方向 | 直角  |
| 位数   | 200 |

### 电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| DRAM 电压 | 1.8 V |
|---------|-------|

### 信号特征

|          |       |
|----------|-------|
| SGRAM 电压 | 1.8 V |
|----------|-------|

### 主体特性

|       |     |
|-------|-----|
| 弹射器位置 | 两端  |
| 插销材料  | 不锈钢 |

|        |       |
|--------|-------|
| 插销电镀材料 | 锡     |
| 模块钥匙类型 | SGRAM |
| 弹射器类型  | 锁定    |
| 连接器外形  | 标准    |

#### 接触件特性

|                |      |
|----------------|------|
| 内存插槽类型         | 内存卡  |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 镀金   |
| 端子基材           | 铜合金  |
| 端子额定电流 (最大值)   | .5 A |
| 端子接触部电镀材料      | 镀金   |

#### 端接特性

|          |      |
|----------|------|
| 插入种类     | 凸轮   |
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |

#### 机械附件

|            |      |
|------------|------|
| 接合对准类型     | 标准键控 |
| PCB 安装固定   | 带有   |
| PCB 安装固定类型 | 焊钉   |
| 连接器安装类型    | 板安装  |

#### 壳体特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 外壳材料     | 高温热塑塑料          |
| 壳体颜色     | 黑色              |
| 中心线 (间距) | .6 mm [.024 in] |

#### 尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 堆叠高度 | 4 mm [.157 in]   |
| 行间距  | 5.8 mm [.228 in] |

#### 使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C [-67 – 185 °F] |
|--------|----------------------------|

#### 操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

#### 行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

#### 包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 200  |
| 封装方法 | Reel |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力  | 尚未进行焊接工艺可能性审核   |

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | [DDR2 SO DIMM](#)



SO DIMM 插槽(24)

### 客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



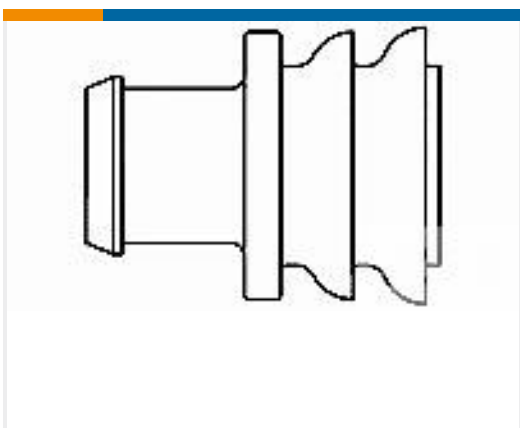
TE 产品编号0460-202-16141  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

### 文档

#### 产品图纸

[EMBOSS DDR2 SODIMM 200P 4H STD](#)

英文版本

#### CAD 文件

##### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_292406-4\\_B2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

##### 3D PDF

3D

##### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_292406-4\\_B2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

##### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_292406-4\\_B2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



---

**产品规格**

产品规格

英文版本